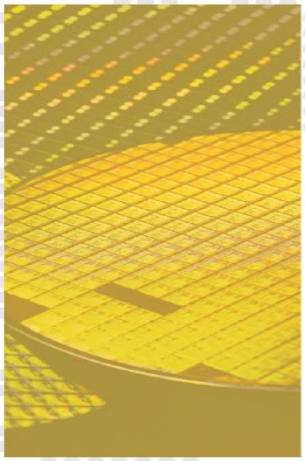
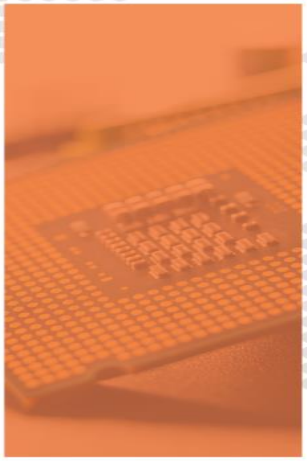
중소기업의 교육 토탈 솔루션
국가인적자원개발 컨소시엄

nepes corporation

(주)네패스 국가인적자원개발 컨소시엄


고용노동부 국가인적자원개발컨소시엄 HRDK 한국산업인력공단

(주)네패스 국가인적자원개발컨소시엄

컨소시엄 사업안내



추진배경

대기업에 비해 상대적으로 직업능력개발이 어려운 중소기업 근로자의 훈련 활성화를 위해 '01년부터 추진

사업목적

중소기업 재직근로자의 직업훈련 참여 확대와 우수 인력공급, 신성장동력분야 등 전략산업의 인력육성, 지역별 직업훈련기반 조성 등을 위한 공동훈련사업(이하 "컨소시엄 사업"이라 한다)

*운영기관 : 고용보험법 등에 따라 컨소시엄 사업을 실시하는 기관



협약기업 혜택

- 컨소시엄 협약기업의 니즈에 부합하는 교육과정 개발지원
  -훈련과정에 대한 수요조사를 바탕으로 기업 맞춤형 과정운영
- 훈련비 환급 행정 편의 제공
  -사업주 훈련비 환급에 따른 행정절차를 운영기관에서 대행함에 따라 행정 편의 제공
- 단체교육 및 교육 컨설팅 지원
  -기업에서 요청 시 맞춤형 단체교육 실시 및 교육 컨설팅 지원

교육대상

- 중소기업 및 고용보험법에 따른 우선지원대상기업
  (제조업 500명 이하, 광업·건설업·운수·창고·통신업 300명 이하, 기타 100명 이하)
- 상시 근로자 300인 미만 중소기업 또는 고용보험법 시행령 제15조 우선지원 대상기업으로 고용보험 연체사실이 없는 기업

'23년도 CHAMP 주요과정 소개

교 육 명 시스템 반도체를 통한 패키지 제품설계
학습대상 반도체관련 실무자
학습기간 총 8시간(1일/8시간,1일)

4차 산업혁명과 함께 시스템반도체의 늘어나는 수요를 충족시키기 위해 패키지 제품을 설계할 수 있는 전문가를 양성할 수 있다.

교 육 명 반도체 패키지 공정
학습대상 반도체 패키지 공정 관련 실무자
학습기간 총 16시간(1일/8시간, 2일)

생산된 반도체 칩을 보호하는 기능과 칩을 전기적으로 연결하기 위하여, 설계된 패키지 제품의 요구사항에 따라 반도체 조립공정을 수행하는 전반적인 패키지 공정의 프로세스를 이해하고 그 개념을 정립할 수 있다.

교 육 명 반도체 신입사원 후공정 프로세스의 이해
학습대상 반도체 분야 재직자(신입사원 등)
학습기간 총 24시간(1일/8시간, 3일)

반도체 분야 신입사원의 각 공정별 특징과 프로세스 이해 수준을 향상시키고 빠른 현업 적응과 현장과의 의사소통 능력을 향상시킬 수 있다.

교 육 명 현장 직무능력 향상을 통한 생산성 증대
학습대상 제조업 분야 재직자
학습기간 총 8시간(1일/8시간,1일)

제조업 관리자들의 전문지식과 문제해결 능력 향상을 통해 제품 비용과 TAT(Turn Around Time) 단축을 하여 생산성 증대를 가져올 수 있다.

교 육 명 7가지 낭비제거를 통한 원가절감 및 품질개선
학습대상 제조업 분야 재직자
학습기간 총 8시간(1일/8시간,1일)

현장에서 알아야 하는 낭비제거요소를 이해하고 이를 통해 원가를 절감하여 제품생산의 효율성과 추가로 품질교육을 통해 안정된 제품생산을 할 수 있도록 한다.

'23년도 CHAMP 신규과정 소개

교 육 명 FO(Fan Out) 패키지 공정
학습대상 반도체 분야 관련 실무자
학습기간 총 7시간(1일/7시간, 1일)

생산된 반도체 칩을 보호하는 기능과 칩을 전기적으로 연결하기 위하여, 설계된 패키지 제품의 요구사항에 따라 반도체 조립공정을 할 수 있는 반도체 분야 재직자의 능력을 향상할 수 있다.

교 육 명 범핑 공정 프로세스 이해
학습대상 반도체 분야 관련 실무자
학습기간 총 8시간(1일/8시간, 1일)

범핑 공정은 반도체 칩에 전류를 흐르게 하는 단자 역할을 하며, Flip Chip이 용이 하도록 전극의 높이를 높이고, 전극 재료를 외부 전극과 접속이 용이하도록 돌기를 형성하는 공정 분야 재직자의 능력을 향상할 수 있다.

교 육 명 테스트 공정 프로세스 이해
학습대상 반도체 분야 실무자
학습기간 총 8시간(1일/8시간, 1일)

테스트 공정은 Tester 장비와 Prober 장비를 이용하여 디바이스별 PGM을 로딩 후, 프로브 카드를 매개체로 웨이퍼 상태에서 전기신호를 걸어 전기적 특성 검사로 양품/불량을 판별하는 공정 분야 재직자의 능력을 향상할 수 있다.

교육일정 매월 상시운영

연번	과정명	교육시간	교육일정											
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	시스템 반도체를 통한 패키지 제품 설계	8th	●		●						●		●	
2	반도체 패키지 공정	16th				●				●				●
3	반도체 신입사원 후공정 프로세스의 이해	24th						●						
4	현장 직무능력 향상을 통한 생산성 증대	8th							●					
5	7가지 낭비제거를 통한 원가절감 및 품질개선	8th												●
6	FO(Fan Out) 패키지 공정	7th		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
7	범핑 공정 프로세스 이해	8th	●		●		●				●			
8	테스트 공정 프로세스 이해	8th		●			●			●		●		

※ 교육일정은 내부사정에 따라 변동될 수 있습니다.

교육시설현황

서울사무소 (서초구 예술의 전당 건너편)

최첨단 교육장비와 최대 35명까지 수용 가능한 교육장

휴게시간에 편히 쉴 수 있는 야외 카페테라스

청주 1캠퍼스

최대 30명까지 수용 가능한 최신 교육장

휴게시간에 편히 쉴 수 있는 사내 카페

청주 2캠퍼스

최대 40명까지 수용 가능한 교육장

출출함을 달래주는 사내 매점

청안 3캠퍼스

최대 40명까지 수용 가능한 교육장

휴게시간에 편히 쉴 수 있는 사내 카페

괴산 연수원

10명에서 최대 80명까지 다양하게 수용 가능한 규모의 교육장

최대 70명까지 수용할 수 있는 계단식 교육장

분임식 교육과 회의 목적으로 이용 가능한 세미나실

최대 65명까지 수용할 수 있는 숙박시설

2023 네패스 CHAMP 협약기업 수요조사 QR Code

협약방법 (전화 및 E-mail 문의)
- 협약서 작성 → 원본 제출 → 협약 완료 → 교육수강

교육참가비
- 무료 수강
(우선지원 대상기업으로 ㈜ 네패스와 컨소시엄 협약을 맺은 기업의 재직자)

교육신청
- E-mail 접수

협약 및 교육문의
- 임병재 스타 : ibj1408@nepes.co.kr
- 반재원 스타 : bjw0824@nepes.co.kr

교육장소
- 서　울 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2415 서초동 하임사옥
- 청주1 : 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 116
- 청주2 : 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-32
- 청안3 : 충북 괴산군 청안면 네패스로 30
- 연수원 : 충북 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1

※ 교육신청은 개강일 일주일 전까지 선착순으로 접수받고 있습니다.
※ 상기 교육일정은 내부사정에 따라 변동될 수 있습니다.

(주) 네패스 대중소상생 컨소시엄사업 교육 신청